об Особенности перемещения расплавленных зон в поле структурной неоднородности кремния

© А.А. Скворцов, С.М. Зуев, М.В. Корячко, Е.Б. Волошинов Московский политехнический университет E-mail: SkvortsovAA2009@yandex.ru

Поступило в Редакцию 5 апреля 2017 г.

Рассмотрены формирование и динамика расплавленных включений Al–Si в кремнии (в диапазоне температур 1123–1273 K) в поле градиента концентрации дислокаций. Обнаружено, что расплавленное включение перемещается как целое по механизму "плавление-кристаллизация": в области с большей концентрацией дислокаций на фронтальной границе наблюдается растворение, а в области с меньшей, на тыльной стороне, — кристаллизация. Экспериментально зафиксированы скорости и энергии активации процесса миграции. Показано, что лимитирующей стадией миграции включений являются процессы плавления-кристаллизации на межфазных границах расплава с матрицей.

DOI: 10.21883/PJTF.2017.15.44869.16814

Образование и динамика расплавленных включений в полупроводниках проявляются при росте кристаллов [1,2], включая зонную перекристаллизацию [3], при легировании [4], а также при тепловой деградации межфазных границ металл-полупроводник [5,6]. Следует отметить, что динамика расплавленных зон в кристаллах возможна и в условиях неоднородного распределения структурных дефектов (вакансии, дислокации). Однако в полупроводниках (в отличие, например, от ионных кристаллов [7]) подобные вопросы практически не рассмотрены, хотя подсистема структурных дефектов в материаловедении полупроводников играет в ряде случаев ключевую роль [8–10].

Поэтому далее будут рассмотрены вопросы образования и направленной миграции расплавленных зон типа металл—полупроводник в монокристаллическом кремнии в присутствии поля градиента плотности дислокаций.

42



Рис. 1. *а* — схема формирования и миграции расплавленного включения в поле градиента концентрации дислокаций: *1* — образец монокристаллического кремния плотностью дислокаций $N_d \sim 10^3 \, 1/\text{cm}^2$; *2* — расплавленное включение; *3* — пленка алюминия; *4* — образец монокристаллического кремния $N_d \sim 10^4 - 10^7 \, 1/\text{cm}^2$. *b* — распределение N_d по длине составного образца.

Известно [7,8,11], что макроскопическое включение в кристалле может перемещаться как целое либо в поле градиента химического потенциала, поддерживаемого извне, либо под влиянием сил, внутренних по отношению к кристаллу. При этом влияние структурной неоднородности кристалла, как правило, не рассматривается. Однако это можно делать далеко не всегда, и часто движение макроскопических включений в кристаллах может происходить в поле структурной неоднородности, в том числе дислокационной.

Рассмотрим макроскопическое включение (рис. 1, *a*), расположенное в матрице вдоль неоднородного распределения дислокаций (рис. 1, *b*).

Как показано в [7], на диаметрально противоположных участках поверхности, ограничивающей включение радиуса R, плотность дислокаций отличается на величину $\Delta N_d = (dN_d/dx)\ell$). При этом рассмотрим наиболее распространенный случай, когда характерный размер включения $\ell = 2R$ в направлении x существенно превосходит среднее расстояние между дислокациями, т. е. при $\ell >> N_d^{-1/2}$.

Ситуация, подобная изображенной на рис. 1, *a*, может реализоваться в условиях, когда диффузионная подвижность атомов матрицы в твердой фазе мала (например, при отсутствии внешних силовых воздействий). В случае, когда вещество матрицы растворимо во включении, через объем включения возможен облегченный диффузионный путь транспорта вещества [7,11,12].

Известно [7,12], что различия в плотности дислокаций ΔN_d определяет изменение химических потенциалов атомов $\Delta \mu_k = \varepsilon \omega_k \Delta N_d$, где ε — энергия дислокации единичной длины, ω_k — атомный объем в твердой фазе. Величина $\Delta \mu_k = \varepsilon \omega_k (\partial N_d / \partial x) 2R$ в обсуждаемом случае является движущей силой растворения вещества матрицы на "лобовой" и осаждения на "тыльной" поверхностях включения или, что то же, смещения включения как целого с некоторой скоростью w.

В работе [7] показано, что размерная зависимость скорости миграции расплавленной зоны в этом случае имеет вид

$$w = \frac{\overline{\beta}cD_i}{cD_i + \overline{\beta}\omega_i kT\ell} \bigg(\varepsilon \omega_k \, \frac{\partial N_d}{\partial x} \, \ell - \Delta \mu^* \bigg), \tag{1}$$

где $\Delta \mu^* = \Delta \mu_p^* + \Delta \mu_0^*$; $\Delta \mu_p^*$, $\Delta \mu_0^*$ — скачки химического потенциала на растворяющейся и растущей поверхностях включения; $\overline{\beta} = \frac{\beta_0 \beta_p}{\beta_0 + \beta_p}$; β_0 , β_p — нормированные на kT удельные потоки растворения и кристаллизации; D_i , ω_i , c — коэффициент диффузии, атомный объем и концентрация в объеме включения.

Из (1) следует, что при $\varepsilon \omega_k \frac{\partial N_d}{\partial x} \ell \leq \frac{\Delta \mu^*}{\varepsilon \omega_k}$ включение двигаться не будет. Оценки, проведенные в [7], показывают, что смещаться будут только те включения, у которых плотность дислокаций на лобовой и тыльной поверхностях отличается на величину $\Delta N_d \sim 10^6 - 10^8 \text{ cm}^{-2}$.

Проанализируем уравнение (1) в предельном случае, когда лимитирующей стадией являются процессы растворения—кристаллизации $(cD_i \gg \overline{\beta} \omega_i kT\ell)$:

$$w = \overline{\beta} \omega_k \left(\varepsilon \omega_k \, \frac{\partial N_d}{\partial x} \, 2R - \Delta \mu^* \right)$$



Рис. 2. Размерная зависимость скорости движения включений при различных температурах, К: *I* — 1123, *2* — 1173, *3* — 1223, *4* — 1273.

Таким образом, в "кинетическом" режиме скорость включения зависит линейно от его размера.

В случае диффузионного контроля $(cD_i \ll \overline{\beta}\omega_i kT\ell)$, когда процесс миграции лимитируется диффузией, уравнение (1) имеет вид

$$w = \frac{cD_i\omega_k}{\omega_i kT} \left(\varepsilon \omega_k \frac{\partial N_d}{\partial x} - \frac{\Delta \mu^*}{\ell} \right)$$



Рис. 3. Фотография закристаллизованного включения Al-Si(a) и дислокационной структуры, возникающей после кристаллизации зоны (b).

Экспериментальная проверка осуществлялась на монокристаллическом кремнии *n*-типа размером $3 \times 3 \times 15 \text{ mm}$ ($\rho = 1\Omega \cdot \text{cm}$). Градиент концентрации дислокаций создавался изгибом образцов при температуре 1323 К. Полученные образцы разрезались в месте максимального градиента, после чего между торцами образцов зажималась тонкая пленка алюминия и производился отжиг в инертной атмосфере в диапазоне температур $T = 800 - 1100^{\circ}$ С. Методика проведения опытов

детально изложена в [11]. Единственным отличием было наличие поля дислокаций, плотность которых выявлялась по ямкам травления.

Как и ранее [11], возникновение расплавленных зон в объеме матрицы при отжиге в диапазоне температур (1123–1273 К) связано с процессами сплавообразования примесной металлической пленки с монокристаллом на границе раздела металл-полупроводник (при температурах выше температуры плавления эвтектики Al–Si, которая составляет 850 К).

Размер и глубину проникновения включений в матрицу от границы определяли последовательной шлифовкой слоев через каждые 5–10 µm с последующей идентификацией включений при помощи оптического микроскопа. Размер включений после кристаллизации лежал в диапазоне 20–250 µm.

Типичные результаты исследований приведены на рис. 2. Нетрудно видеть, что размерные зависимости скорости движения включений в диапазоне температур (1100–1300 K) носят линейный характер, что свидетельствует в пользу кинетического режима движения включений. Полученные энергии активации ($E_a = 0.9-1.5 \,\mathrm{eV}$) по температурным зависимостям скорости миграции включений разного размера (20–60 μ m) также свидетельствуют в пользу лимитирующих механизмов, связанных с процессами плавления—кристаллизации в процессе движения зоны в поле градиента концентрации дислокаций.

Следует также подчеркнуть, что процессы кристаллизации на тыльной стороне включения могут приводить к образованию новых дислокаций вокруг включения, что может существенно изменить N_d по сравнению с первоначальным распределением (рис. 3).

Таким образом, в работе рассмотрена динамика миграции расплавленных включений Al–Si в монокристаллическом кремнии при наличии поля структурной неоднородности в виде дислокаций. Показано, что возникающие зоны движутся в поле градиента концентрации дислокаций в область с большей концентрацией. Экспериментально зафиксированы скорости и энергии активации процесса миграции. Показано, что лимитирующей стадией миграции зон являются процессы плавления-кристаллизации на межфазных границах расплава с матрицей.

Работа выполнена в рамках проекта Министерства образования и науки РФ, № 8.5171.2017/БЧ.

Список литературы

- [1] Abe T., Takahashi T., Shirai K. // J. Cryst. Growth. 2017. V. 459. P. 87-94.
- [2] Talanin V.I., Talanin I.E., Ustimenko N.P. // Crystallogr. Reports. 2012. V. 57. Iss. 7. P. 898–902.
- [3] Грабов В.М., Комаров В.А., Каблукова Н.С. и др. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. В. 1. С. 20–27.
- [4] Demireva D., Ziffudin L., Barbova M. // Semicond. Sci. Technol. 1998. V. 13. Iss. 11. P. 1290–1293.
- [5] Skvortsov A.A., Zuev S.M., Koryachko M.V., Glinskiy V.V. // Microelectron. Int. 2016. V. 33. Iss. 2. P. 102–106.
- [6] Скворцов А.А., Каленков С.Г., Корячко М.В. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. В. 18. С. 24–32.
- [7] Дзюба А.С. // ФТТ. 1977. Т. 19. V. 1. С. 78-82.
- [8] Costa I., Brito M.C., Gaspar G. et al. // Semicond. Sci. Technol. 2013. V. 28 (12).
 P. 125023 (1–6).
- [9] Eslamian M., Saghir M.Z. // Int. J. Therm. Sci. 2011. V. 50. Iss. 7. P. 1232–1242.
- [10] Wang Y., Kakimoto K. // J. Cryst. Growth. 2003. V. 247. Iss. 1-2. P. 1–12.
- Skvortsov A.A., Khripach N.A., Zaletov D.V., Pshonkin D.E. // Res. J. Pharmaceut. Biol. Chem. Sci. 2016. V. 7. Iss. 6. P. 998–1003.
- [12] Гегузин Я.Е., Кривоглаз М.А. Движение макроскопических включений в твердых телах. М.: Металлургия, 1971. 344 с.